

RYOYO Edge AI Platform

Retail
Digital Signage
Factory
Mobility



NEXCOM JAPAN
各種産業用 PC
オンラインカタログ



産業用 PC・ゲートウェイ
車載 PC
タッチパネル PC
リテール&サイネージ PC
ネットワーク PC
IP カメラ

NEXCOM JAPAN
季刊発行情報誌
NEXCOM Express



イプロスものづくり
菱洋エレクトロ
NEXCOM 製品一覧



●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2024年5月現在のものです。 2024051000

【製造販売元】



株式会社ネクコム・ジャパン

〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 田町ハラビル9階
TEL : 03-5419-7830 FAX : 03-5419-7832
Email : sales@nexcom-jp.com
URL : https://www.nexcom-jp.com

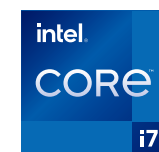
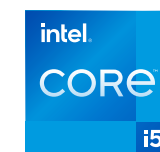
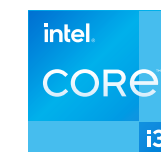
【問い合わせ先】



菱洋エレクトロ株式会社

〒104-8408 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル
TEL : 03-3546-5015 FAX : 03-3543-2212
Email : nexcom_info@ryoyo.co.jp
URL : https://www.ryoyo.co.jp

2024年4月1日、(株)リョーサンと菱洋エレクトロ(株)が経営統合し、「リョーサン菱洋ホールディングス(株)」が誕生しました。



Neu-X・NDiS・NISE・TT・VTC シリーズ

Ryoyo は Edge AI のハードウェアおよびソフトウェアパートナーとともにオープンな Edge AI ソリューションを提供しています

RYOYO Ryoyo Edge AI Platform

スマートフォンの出荷台数が 11.7 億台、PC の出荷台数が 2.6 億台であるのに対し、世界の年間マイコン (CPU) 出荷数量は約 300 億個に達します。巨大な Edge AI の市場のニーズに応えるため、Ryoyo は Edge AI のハードウェアおよびソフトウェアパートナーとともに、オープンな Edge AI のソリューション提案にむけた Ryoyo Edge AI Platform を構築しています。

Ryoyo-NEXCOM Edge AI PC

幅広い要望にお応えする
バリエーションで



世界の年間マイコン (CPU)
出荷数量 約 300 億個
エッジ AI の市場規模

Ryoyo Edge AI Software Partners

最先端の AI ソフトウェアを

Integration

故障予測
物体認識
顔認識
LLM
姿勢推定
OCR

Services

一早く市場のエッジへ

リテール 製造 ヘルスケア スマートアグリ

Ryoyo-NEXCOM Edge AI PC について

- 幅広いラインナップの NEXCOM 製品から、高度な AI 処理を実現できる演算性能を持ちながら、様々なエッジの要求にお応えする PC をご提案いたします。
- インテルが無償で提供する AI 推論の開発環境 "OpenVINO ツールキット" により GPU が無くても高速にエッジでの AI 推論を実行できます。
- 菱洋エレクトロは、Intel、NVIDIA の正規代理店です。最新の製品情報、正確なライフサイクルをお伝えします。
- AI を動作させるためのハードウェアだけでなく、アプリケーションを動作させるソフトウェア環境にも習熟した技術スタッフがサポートいたします。

Ryoyo Edge AI Software Partners について

- 多くの AI ソフトウェアベンダー様にご賛同いただいております。Ryoyo-NEXCOM Edge AI PC 上で動作する幅広い Edge AI のソフトウェアをご提案できます。こんなことをやりたい、これに困っている、などお気軽にご相談ください。

Ryoyo Edge AI Solution について

- お客様のご要望に合わせて、Edge AI PC とソフトウェアを組合わせてご提案します。



Ryoyo Edge AI Software Partners



Ryoyo Edge AI Solution

Intel 社の正規販売代理店として Intel Embedded (Intel 社の IoT および組み込みアプリケーション向け製品) を提供しています

インテル® OpenVINO™ ツールキット

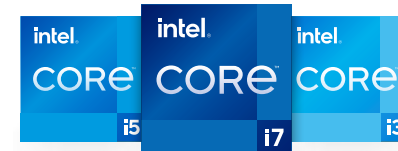
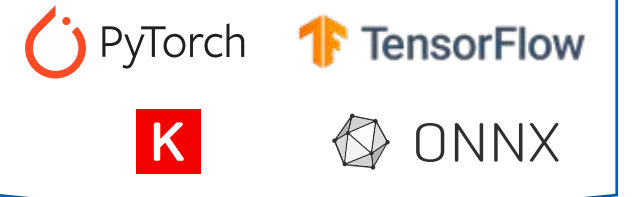
RYOYO

OpenVINO™ ツールキットは、インテルが無償で提供しているインテル製の CPU や GPU、NPU、FPGA などのパフォーマンスを最大限に活用して、コンピューター・ビジョン、画像関係をはじめ、自然言語処理や音声処理など、幅広いディープラーニング・モデルで推論を最適化し高速化する推論エンジン / ツールスイートです。AI アプリケーションの推論部分に OpenVINO™ ツールキットを使用することで、サービスやソリューションの開発者は、ハードウェアを変更することなく、簡単なコードで AI のパフォーマンスを加速できます。

① PyTorch、TensorFlow、Keras、ONNX など
お好みのフレームワークでモデル作成、学習

② Model Converter で 学習済みモデルを
OpenVINO フォーマットに変換

③ CPU、GPU、NPU など様々なインテルプラットフォームへ最適化された推論エンジン
Python/C/C++ でプログラム作成



インテル® Core™ プロセッサの種類

インテル® Core™ プロセッサは、デスクトップ PC で使われるソケットタイプの S シリーズ、ノート PC で使われる BGA タイプの P シリーズ、組み込み専用でソケットタイプの PS シリーズの 3 つがあります。それぞれ複数の TDP (熱設計電力) のバリエーションがあります。

	特徴	型名 (第13世代 Core™ i7の例)	型名(Core™ i7 (第 14 世代) 及び Core™ Ultra 7 (Series1)) の例	TDP
Sシリーズ	・ LGA パッケージでソケットに載せ替え可能 ・ 高いCPU性能 ・ 豊富なI/O	Core™ i7-13700E	Core™ i7-14700	65W
		Core™ i7-13700TE	Core™ i7-14700T	35W
Pシリーズ	・ BGA/パッケージで基板に実装 ・ 低消費電力	Core™ i7-13800HE	—	45W
		Core™ i7-1370PE	Core™ Ultra 7 165H	28W
		Core™ i7-1365UE	Core™ Ultra 7 165U	15W
PSシリーズ	・ LGA パッケージでソケットに載せ替え可能 ・ 低消費電力	Core™ i7-160HL	Core™ Ultra 7 165HL	45W
		Core™ i7-160UL	Core™ Ultra 7 165UL	15W

* 第 13 世代 Core™ i7 S-Series と PS-Series は同じ LGA1700 ですが置き換えはできません。

Intel 社の正規販売代理店として Intel Embedded (Intel 社の IoT および組み込みアプリケーション向け製品) を提供しています

RYOYO Intel プロセッサと Windows バージョン組み合わせ表

Intel® Core™ シリーズ プロセッサ 組み合わせ表

※こちらは一般向けではなく組み込み系の OS、CPU の対照表となります。

プロセッサ世代	コードネーム	Launch	リソグラフィ	メモリ規格	対応OS
第14世代	Raptor Lake-S Refresh	Q1'24	Intel 7	DDR5 DDR4 LPDDR5	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Windows11対応予定)
第13世代	Raptor Lake	Q1'23	Intel 7	DDR5 DDR4 LPDDR5	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Windows11対応予定)
第12世代	Alder Lake	Q4'21~Q2'22	Intel 7	DDR5 DDR4 LPDDR5	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Windows11対応予定)
第11世代	Tiger Lake	Q3'20~Q3'21	10nm	DDR4 LPDDR4	Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 LTSC
第10世代	Comet Lake	Q3'19~Q1'21	10nm 14nm	DDR4 LPDDR4 LPDDR3	Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 LTSC
第9世代	Coffee Lake Refresh	Q4'18~Q4'19	14nm	DDR4 LPDDR3	Windows 10 IoT Enterprise 2016/2019 LTSC
第8世代	Whiskey Lake	Q3'17~Q4'19	14nm	DDR4 DDR3 LPDDR3	Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 LTSC
	Coffee Lake				Windows 10 IoT Enterprise 2016/2019 LTSC

Intel Atom® プロセッサ 組み合わせ表

※こちらは一般向けではなく組み込み系の OS、CPU の対照表となります。

シリーズ名	コードネーム	Launch	リソグラフィ	メモリ規格	対応OS
Atom x7000 シリーズ	Alder Lake-N	Q2'23	Intel 7	LPDDR5 DDR5 DDR4	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Windows11対応予定)
Atom x6000 シリーズ	Elkhart Lake	Q1'21	10nm	LPDDR4 DDR4	Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 LTSC
Atom E3900 シリーズ	Apollo Lake	Q4'16	14nm	LPDDR4 DDR3L	Windows 10 IoT Enterprise 2016/2019 LTSC
Atom E3800 シリーズ	Bay Trail	Q4'13~Q4'14	22nm	DDR3L	Windows 10 IoT Enterprise 2015/2016 LTSC

インテル® プロセッサがサポートする IoT アプリケーション向け
Microsoft Windows IoT Enterprise および Microsoft Windows Server



<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/internet-of-things/window-processor-server-support.html>

Microsoft 社 Windows Embedded の正規販売代理店として組み込み機器向け OS の提供しています

RYOYO Windows Embedded OS (Client 系) 一覧表

グループ	製品名	メインストリームサポート ※1	延長フェーズサポート ※2	供給終了日 ※3	
Client	WES	Windows Embedded 8 Standard	2018年 7月10日	2023年 7月11日	2028年 3月31日
	WES	Windows Embedded Standard 7	2015年10月13日	2020年10月13日	2025年 7月27日
	WES	Windows Embedded Standard 2009	2014年 1月14日	2019年 1月 8日	2024年 1月 8日
	FES	Windows Embedded 8.1 Pro	2018年 1月 9日	2023年 1月10日	2028年 3月31日
	FES	Windows Embedded 8 Pro	2018年 1月 9日	2023年 1月10日	2028年 3月31日
	FES	Windows 7 Ultimate for Embedded Systems	2015年 1月13日	2020年 1月14日	2024年 9月30日
	FES	Windows 7 Professional for Embedded Systems	2015年 1月13日	2020年 1月14日	2024年 9月30日
	IoT	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	2027年 1月12日	2032年 1月13日	2031年11月30日
	IoT	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	2024年 1月 9日	2029年 1月 9日	2028年11月30日
	IoT	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB	2021年10月12日	2026年10月13日	2026年 7月31日
	IoT	Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB	2020年10月14日	2025年10月14日	2025年 7月31日
	WEP	Windows Embedded 8.1 Industry	2018年 7月10日	2023年 7月11日	2028年 4月30日
	WEP	Windows Embedded 8 Industry	2018年 7月10日	2023年 7月11日	2028年 4月30日
	WEP	Windows Embedded POS Ready 7	2016年10月11日	2021年10月12日	2026年 9月10日
	WEP	Windows Embedded POS Ready 2009	2014年 4月 8日	2019年 4月 9日	2024年 2月11日
	WEC	Windows Embedded Compact 2013	2018年10月 9日	2023年10月10日	2028年 5月31日
WEC	Windows Embedded Compact 7	2016年 4月12日	2021年 4月13日	2026年 2月28日	
WEC	Windows Embedded CE 6.0	2013年 4月 9日	2018年 4月10日	2022年 2月28日	
Server	IoT	Windows Server IoT 2022	2026年10月13日	2031年10月14日	2031年12月31日
	IoT	Windows Server IoT 2019	2024年 1月 9日	2029年 1月 9日	2030年 6月30日
	FES	Windows Server 2016 for Embedded Systems	2022年 1月11日	2027年 1月11日	2031年12月31日
STB	WSS	Windows Server IoT 2022 for Storage	2026年10月13日	2031年10月14日	2031年12月31日
	WSS	Windows Server IoT 2019 for Storage	2024年 1月 9日	2029年 1月 9日	2030年 6月30日
SQL	FES	SQL Server 2022	2028年 1月11日	2033年 1月11日	2033年 3月31日
	FES	SQL Server 2019	2025年 2月28日	2030年 1月 8日	2029年12月31日

※1 メインストリームサポート：バグフィックス、セキュリティ更新プログラムの提供
 ※2 延長フェーズサポート：セキュリティ更新プログラムの提供
 ※3 供給終了日：OEM 様からの Embedded System 最終出荷可能日

※予告なく変更となる可能性がございます。最新情報は QR コードまたは下記 URL よりご確認ください。



<https://ryo-yo-embedded-solutions.jp/microsoft/>

Neu-X303

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 4Kビデオ再生対応スマートシティコントローラ

SoCでソケットタイプ、第12世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載した Neu-X303 シリーズのエッジコンピューティングシステムは、非常にリッチなマルチメディアコンテンツや AI 処理を扱うことができます。Intel® Iris® Xe グラフィックスによる強力なグラフィックスは、4K の再生やコンテンツ制作など圧倒的なグラフィックを提供します。

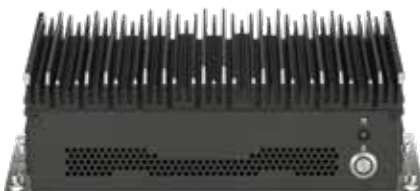


マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X303

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (15W)
搭載可能CPU：
i3-1215UL (6 Core 2P4E, 8スレッド)
i5-1235UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i5-1245UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1255UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)
i7-1265UL (10 Core 2P8E, 12スレッド)



Neu-X303 背面

- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB
- LAN x 2, USB3.2 x 4
- HDMI2.1 x 1, DisplayPort x 1, USB type-C x 2 (ビデオ出力)
- M.2 x 1 (SSD), M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 190mm (W) x 150mm (D) x 60mm (H)

重量 1.9 kg

動作温度範囲 0 ~ 50°C

Neu-X303mini

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 コンパクトなエッジコンピューティングシステム

次世代プロセッサを搭載可能な Neu-X303mini は、AI 処理をはじめ、USB、Type-C ポート x2 を含む豊富な I/O を備えたコンパクトなエッジコンピューティングシステムで、高度なグラフィック処理や AI を駆使したアプリケーション等、ビジュアル・エッジ・コンピューターとしても理想的です。



マザーボード単体
ご提供可能



CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (45W)
搭載可能CPU：
i3-12300HL (8 Core 4P4E, 12スレッド)
i5-12500HL (12 Core 4P8E, 16スレッド)
i5-12600HL (12 Core 4P8E, 16スレッド)
i7-12700HL (14 Core 6P8E, 20スレッド)
i7-12800HL (14 Core 6P8E, 20スレッド)



Neu-X303mini



Neu-X303mini 背面

- Intel® UHD Graphics / Intel® Iris® Xe Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB
- LAN x 2, USB3.2 x 4
- HDMI2.1 x 1, DisplayPort x 1, USB type-C x 2 (ビデオ出力)
- M.2 x 1 (SSD), M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 183mm (W) x 138mm (D) x 48mm (H)

重量 1.5 kg

動作温度範囲 0 ~ 60°C

Neu-X304-H610

IoT エッジ向け第12/13世代 Intel プロセッサ搭載

新型 CPU を搭載可能な Neu-X304 システムは、新時代の AI とビジュアルエッジコンピューティングの性能と効率の融合を提供し、ヘルスケアサービス、公共交通機関の監視、デジタル教育システム、AI 認識、データセンター・クラウドコンピューティングなど、産業における多目的なアプリケーションをサポートします。



マザーボード単体
ご提供可能



Neu-X304-H610

CPUタイプ：
第12/13世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)
Core i9-12900TE (16 Core 8P8E, 24スレッド)
Core i3-13100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-13500TE (14 Core 6P8E, 20スレッド)
Core i7-13700TE (16 Core 8P8E, 24スレッド)
Core i9-13900TE (24 Core 8P16E, 32スレッド)

Neu-X304-Q670 もラインナップ！

- ワイドレンジ (12 ~ 24V DC) 入力
- Intel® AMT (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー) 対応



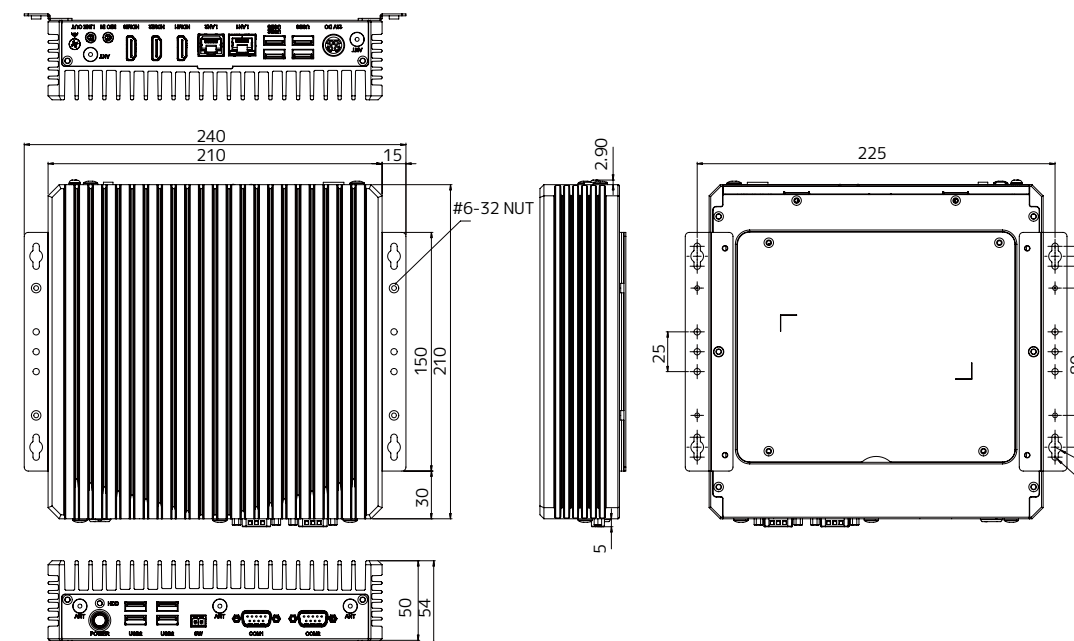
Neu-X304-H610 背面

- Intel® PCH H610E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMMスロット x 2 最大64GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, LAN x 2
- USB3.2 x 3, USB2.0 x 5
- HDMI 2.0 x 3, LVDS x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), Micro-SIMスロット x 1, M.2 x 1 (Wi-Fi)
- リモートスイッチ端子 x 1
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 210mm (W) x 210mm (D) x 50mm (H)

重量 2.6 kg

動作温度範囲 -5°C ~ 45°C



NDiS B561 / NDiS B561-PoE

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 広温度対応 屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561 ファンレス・ビジュアル・エッジ・コンピュータは、強力なマルチメディア・コンテンツを扱うことができ、-20～60℃の幅広い動作温度範囲に対応します。3つの独立ディスプレイ出力で最大 8K@60Hz の出力が可能で、豊富な接続機能を備えています。PoE ポート x2 を含む LAN ポート x3 の NDiS B561-PoE (動作温度範囲 0℃～40℃) もラインナップしました。



NDiS B561

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

NDiS B561 :
• LAN x 3
• +12~24V DC入力
• 12V DC / 120W ACアダプタ付属

NDiS B561-PoE :
• LAN x 1, LAN (PoE) x 2
• 24V DC入力
• 24V DC / 180W ACアダプタ付属

- Intel® Q670E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, USB3.2 x 8

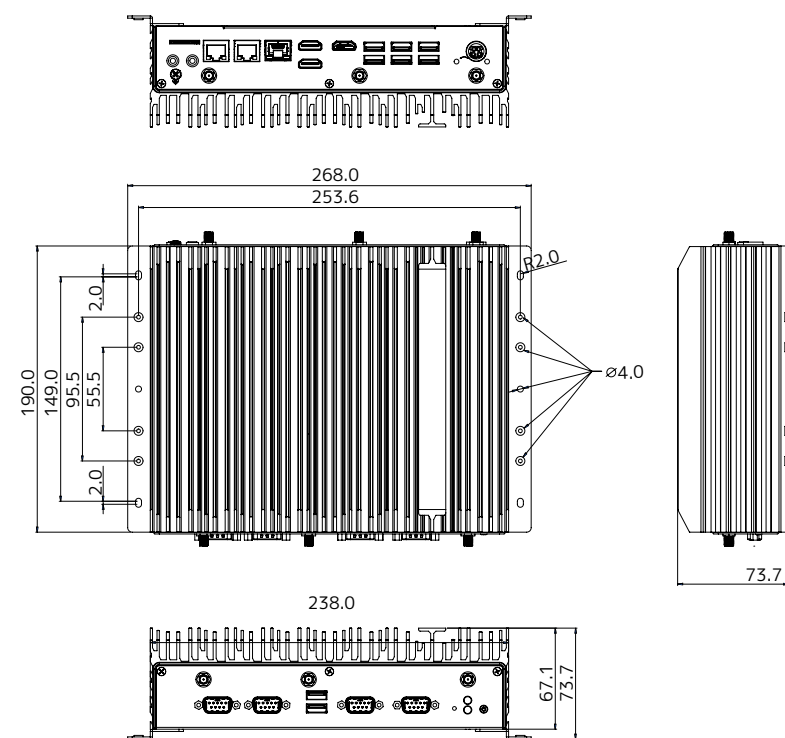
- HDMI2.0 x 2, HDMI2.1 x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1
- M.2 x 1 (Wi-Fi)

外形寸法 238mm (W) x 190mm (D) x 68mm (H)

重量 4.0kg

動作温度範囲 NDiS B561 : -20℃～60℃

動作温度範囲 NDiS B561-PoE : 0℃～40℃



NDiS B561 背面

NDiS B561S

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載 スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け



NDiS B561S は、NDiS B561 と同じマザーボードにバリューなチップセットを搭載し、低価格を実現しました。スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0℃～50℃と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。



NDiS B561S

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ (35W)
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE (4 Core 4P0E, 8スレッド)
Core i5-12500TE (6 Core 6P0E, 12スレッド)
Core i7-12700TE (12 Core 8P4E, 20スレッド)

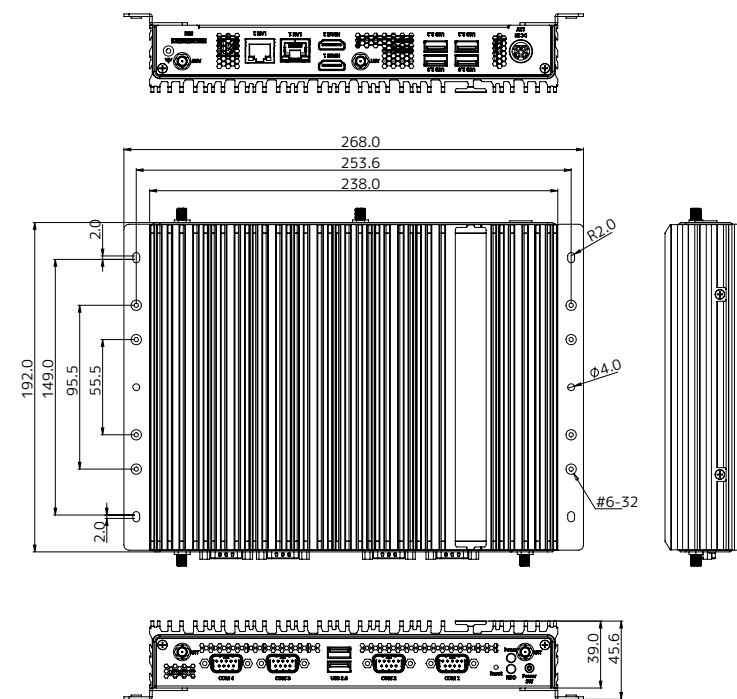
- Intel® H610E
- Intel® UHD Graphics 730 / Intel® UHD Graphics 770
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大64GB (1スロット最大32GB)
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, LAN x 2

- USB3.2 x 2, USB2.0 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 2 (SSD)
- M.2 x 1 (LTE), SIMスロット x 1, M.2 x 1 (Wi-Fi)
- +12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法 238mm (W) x 190mm(D) x 39mm (H)

重量 3.0 kg

動作温度範囲 0℃～50℃



NDiS B561S 背面

NISE 3910 シリーズ

第 12/13 世代 Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 プロセッサ搭載 ハイエンド産業用アプリケーション



NISE 3910 は、NISE 3900 のデザインを継承し、第 12/13 Intel® Core™ プロセッサをサポートします。標準で LAN x4 ポートを装備し、レガシーな VGA ポート、USB x10、COM x4、HDMI と DP、リムーバブル M.2 や LTE モジュールなど、豊富な IO を搭載しました。NISE 3900 同様複数のスロット搭載モデルも継承しています。また NISE シリーズ初めての PCIe(x16) スロット搭載モデルも追加しました。



NISE 3910E/R

NISE 3910E2/P2/P2E/E16

【NISE 3910E, NISE 3910E2/P2/P2E/E16, NISE 3910R 共通仕様】

- Intel® Core™ i3-12100TE (4P4E, 2.1 GHz)
- Intel® Core™ i5-12500TE (6P6E, 1.9 GHz)
- Intel® Core™ i7-12700TE (8P4E, 1.4 GHz)
- Intel® Core™ i9-12900TE (8P8E, 1.1 GHz)
- Intel® Core™ i3-13100TE (4P4E, 2.4 GHz)
- Intel® Core™ i5-13500TE (6P8E, 1.3 GHz)
- Intel® Core™ i7-13700TE (8P8E, 1.1 GHz)
- Intel® Core™ i9-13900TE (8P16E, 1.0 GHz)

- Intel® Q670E
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 最大 64GB
- LAN x 4, USB2.0 x 4, USB3.2 x 6
- HDMI x 1, DisplayPort x 1, VGA x 1
- Mic x 1, Line-out x 1
- リモートスイッチ端子 x 1
- SIM カードスロット x 1
- 12~30V DC入力
- 動作時: -20°C ~ 60°C

- 拡張スロット/ストレージ
- Mini-PCIe x 1 : 4G LTE/mSATA
 - M.2 x 1 : LTE/5G/SATA
 - リムーバブルM.2 (2242) x 1 : NVMe
 - 2.5 インチベイ x 最大 2 : SATA

型番	拡張スロット	1スロットあたりの最大出力(W)	最長 (mm)
NISE 3910E	PCIe(x4) x 1	10	169
NISE 3910E2	PCIe(x4) x 2	10	169 & 240
NISE 3910P2	PCI x 2	10	169 & 240
NISE 3910P2E	PCIe(x4) x 1, PCI x 1	10	169 & 240
NISE 3910E16	PCIe(x16) x 1	75	240



NISE 3910E

【NISE 3910E/R 仕様】

- NISE 3910E : RS232 x 1, RS232/422/485 x 2 (絶縁)
- NISE 3910R : RS232/422/485 x 2 (絶縁)
- 215mm (W) x 272mm (D) x 102mm (H)



【NISE 3910E2/P2/P2E/E16 共通仕様】

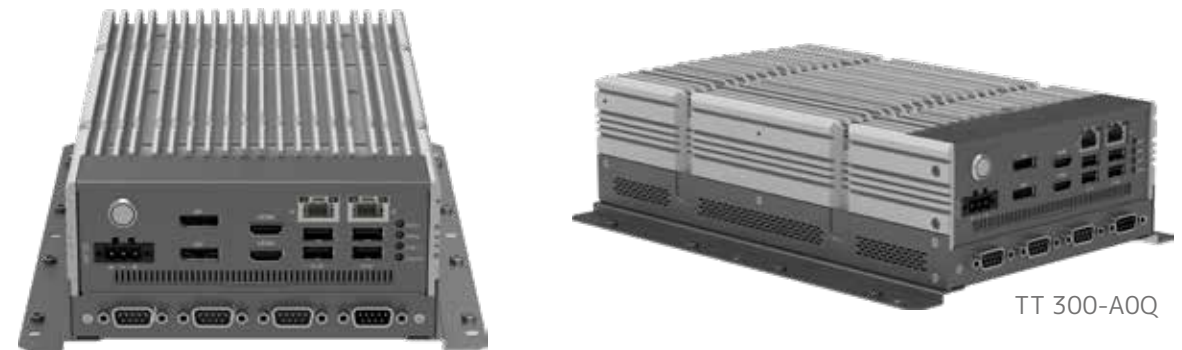
- RS232 x 2, RS232/422/485 x 2 (絶縁)
- 215mm (W) x 272mm (D) x 123mm (H)

TT 300-AxQ シリーズ

第 12/13 世代 Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 プロセッサ対応 オールラウンドファンレスコンピュータ



産業用ファンレス PC としてスタンダードなデザインに回帰したオールラウンドファンレスコンピュータです。スロットレスの TT 300-A0Q や 2 スロットの TT 300-A2Q、3 スロットの TT 300-A3Q の 3 タイプの異なるデザインをご用意しましたので、目的に合わせた最適な PC 環境を構築可能です。豊富な COM や USB 等、基本性能に関しては拡張ボード無しでお使いいただけます。TT 300-A3Q は、グラフィックカード等発熱の高い PCIe(x16) 拡張ボードを実装する際は本体にファンを取り付けることも可能です。Windows10 から Windows11 まで、レガシーなシステムの置き換えから、AI システムまで、ファクトリーのサーバーとして、様々なアプリケーションに対応いたします。



TT 300-A0Q

TT 300-A0Q

- RS232/422/485 x 2, RS232 x 2

- 外形寸法 160mm (W) x 269mm (D) x 56mm (H)
- 重量 約 4.4Kg

TT 300-A2Q

- RS232/422/485 x 2, RS232 x 6
- PCIe (x4) x 2

- 外形寸法 201mm (W) x 270mm (D) x 142mm (H)
- 重量 約 5.1Kg



TT 300-A2Q

TT 300-A3Q

- RS232/422/485 x 2, RS232 x 2
- PCIe (x4) x 2, PCIe(x16) x 1

- 外形寸法 201mm (W) x 270mm (D) x 142mm (H)
- 重量 約 5.1Kg



TT 300-A3Q

【TT 300-AxQ 共通仕様】

- 第12/13世代Intel® Core™ i3/i5/i7プロセッサ対応
- Intel® Q670E PCH
- DDR5 SO-DIMM スロット x 1 最大 32GB
- HDMI x 2, DP x 2, LAN x 2, USB3.0 x 4
- +12Vまたは+24V DC入力
- 動作時: -5°C ~ 55°C

- 2.5インチベイ x 2 (SSDのみ)
- M.2 x 1 : LTE
- M.2 (2280)x 1 : NVMe / SATA
- Mini-PCIe x 1 : LTE または mSATA
- Nano-SIMカードスロット

VTC 7270 / VTC 7270-C4 / VTC 7270-C8

第12世代 Intel® Core™ プロセッサ搭載

AI 搭載の車載用テレマティクスコンピュータ VTC 7270-C4 は、Intel® 第12世代 Alder Lake-S を搭載し、旧世代よりも 30% 高い演算能力を発揮します。2.5GigE PoE+、USB3.2 x6、CAN2.0B (絶縁 2.5KV)、COM ポート x4、NVMe ストレージ、拡張スロット、ディスプレイ x3、多様な周辺機器や機能を備え、高度な車載コンピュータを実現しています。厳しい環境に耐えるため、VTC 7270-C4 は -40°C ~65°C の温度で動作し、耐振動 / 耐衝撃性の軍事規格 MIL-STD-810H に準拠しています。また、CE/FCCclassA、UKCA、E-mark (E13) などの規格に準拠しています。



VTC 7270/VTC7270-C4 前面



VTC7270-C8 前面



ファン付きタイプ

※オプションのファンキット (UTK FAN120-01) 搭載時は 65W CPU 使用可能

VTC7270-C4/VTC7270-C8 背面 I/O部

- 第12/13世代 Intel® Core™ プロセッサ
- Intel® R680E
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2 8GB搭載済 (最大64GB)
- HDMI x 1, VGA x 1, DisplayPort x 1

ATC 7270 : LAN x 3
ATC 7270-C4 : LAN x 1, LAN (PoE) x 4
ATC 7270-C8 : LAN x 1, LAN (PoE) x 8

- USB3.2 x 6, RS232 x 2, RS232/422/485 x 2
- マルチポート (CAN FD (絶縁2.5KV) x 2, DI x 4, DO x 4) x 1
- Line-in x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- 2.5インチベイ x 2, M.2 NVMe x 1
- Mini-PCIe スロット x 2, M.2 x 1 (LTE)
- Nano-SIMスロット x 4 (国内 x 1)
- GPS U-blox NEO-M9N GNSS モジュール x 1
- 9~36V DC 入力 CE, FCC, UKCA, E13

外形寸法 260mm (W) x 210mm (D) x 81mm (H)

重量 5.7 kg / 6.8kg (ファン付きの場合)

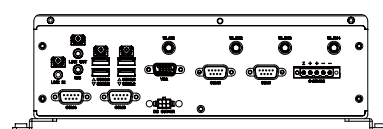
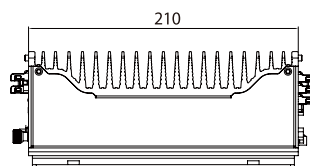
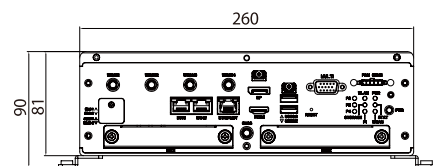
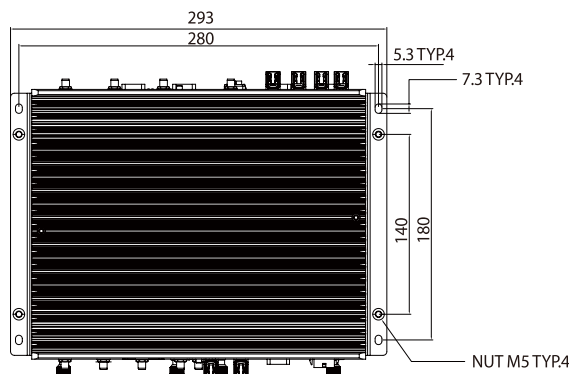
動作温度範囲 VTC7270 :

-35°C ~ 70°C (35W CPU, ファンレス)

VTC7270-C4/C8 :

-35°C ~ 60°C (35W CPU, ファンレス 120W PoE)

-35°C ~ 65°C (35W CPU, ファンレス 60W PoE)



VTC 7270 図面

※デッドレコニング (DR) 機能を使用する場合は、GNSS レシーバモジュールを DR 対応モデル (NEO-M8U/M8L) に変更する必要があります。詳しくは担当営業までご相談ください。



国内向けサポートサービスとオプションサービス

Made in Taiwan こだわりの台湾製造

ネクスコムは自社工場を台湾の二か所に有し、アウトソーシングの PCB 工場も含め、CPU ボードの製造から、システムの組み立て、検査、出荷のほぼすべての業務を台湾国内で行っています。

主要部品の国内調達

PC 内部の各種主要部品 (CPU / メモリ / ストレージ / Windows 等) は日本国内で調達しています。お客様のご要望に合わせた仕様で、取付けやテストを行います。国内調達することで、問題発生時にネクスコム・ジャパンが国内サポートを受けることも可能で、インテル社や日本マイクロソフト社などとも情報を共有しています。

アセンブリ&キッティング イン東京都港区

最終出荷に近い状態でテストやソーティングを実施し、より信頼性の高い製品をお届けできるよう、社内生産を貫いています。社内でアセンブリを行うため、ご要望に合わせた仕様でシステム構築することが可能です。専用のテスト / お客様のアプリケーションのインストール / 梱包時の特別な加工 / 在庫品の管理 / エンドユーザへの直送など様々ご要望に対応しています。お客様の手間を少しでも軽減するお手伝いを致します。

ネクスコム製品は東京・港区より出荷

東京都港区芝という都心でありながら、約 20 年間一貫して国内に組み立て及び出荷業務を有し、利便性を優先、コスト以上の効果として、製品の信頼性向上を目指した環境を整えています。

修理 イン東京都港区

一次解析を含め、修理依頼品の約 9 割を国内で行っており、予備の部品などのストック専用の倉庫も有しています。



長期延長保証

システムご購入の際に、費用をお支払いいただくことにより、最長 5 年間修理費用が無償になるワランティプログラムを用意しています。

貸出機のご用意

購入をご検討の方に、無償貸出しを行っています。仕様に関しては直接ご相談ください。貸出期間は通常 2~4 週間です。

各種認証について

製品は CE/FCC 認証、AC アダプタ等は PSE 認証を取得しています。VCCI/UL/CCC 等の認証が必要な場合は、オプションとして取得することも可能です。



①入庫

台湾から出荷された製品は、毎週成田空港からチャータートラックで配送され、受入検査 (IQC) の後、倉庫へ移動します。国内で調達したパーツ類も同様です。



②作業準備

各種パーツを事前に準備するゾーンでは、パーツの登録、データのコピー、ステッカーの準備などを行い、搭載する PC 毎に整理します。



データのコピー

③アセンブリとキッティング

台湾から届いた PC 本体と国内調達したパーツでのアセンブリを行います。起動確認後に Windows 等の設定、アプリケーションのインストールを実施します。社内サーバに保管されている作業手順書、BIOS データ、Windows イメージを読み出して作業します。本体やパーツのシリアルナンバーや検査結果をサーバに登録します。



パーツの取付け

④動作試験とエージング

注文書と構成の確認を行った後に、社内標準の各種テストを実施し、数時間のバーンインテスト (負荷試験) や製品固有の試験を行います。



パネル PC の出荷前テスト

⑤出荷

各種試験をパスした PC は、外観チェック、清掃の後に、付属品と共に所定の梱包箱に収められ、日本全国に出荷されます。

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは1台から 1台より受注

最低発注数は、システム1台より承ります。

信頼性を高めます 出荷前検査の実施

出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。

面倒な組立てはお任せ アセンブリサービス

ご希望のCPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。

安心の国内サポート 修理・技術サポート

修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。

各種キitting インストール・キitting

ご希望のOS・アプリケーションのインストール、ご指定のCDなどの添付品の同梱等、各種キitting作業も承ります。

貸出無料 評価機貸出

ネクコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18ヶ月間の無償修理保証(標準保証)

標準品は弊社発送日より18ヶ月間の無償修理保証が添付されています。(保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております)

国内での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。

センドバックによる受付

修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認・解析・修理を実施します。

本社(NEXCOM International)での修理対応

ネクコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社のRMAセンターへ発送します。

その他オプションサービス

最長5年延長保証のオプションサポート ワランティプログラム

ネクコム・ジャパン ワランティプログラムは、NDiSシリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長5年間修理費用が無償になるプログラムです。

※詳細は別紙ワランティ規定をご覧ください。

何回でも修理費無料!

年8%とリーズナブル

2,3,4,5年間の選択可

1台から対応

標準保証 18か月 + 延長保証(オプション)

最大5年間

安心の
延長保証

USBでメモリブートし、簡単リカバリ リカバリ USB メモリ添付サービス

パラゴンライト
新登場

製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。出荷時に Windows イメージ USB メモリにリカバリして添付しますので、障害発生時に出荷時の状態に簡単に復旧することができます。また、お客様のアプリケーション等を含めたオリジナルのリカバリイメージを何回でも作成可能です。お客様でイメージを作成するパラゴンライト(USBメモリとパラゴンソフトウェアのみ)も低価格でご用意しています。
(※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。)



【USBリカバリの資料】
NEXCOM テクニカルサポートページ
カタログ・マニュアルダウンロード



カラーチェンジやインターフェースのカスタマイズ ステッカー製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその① キittingサービス

Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キittingサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。

ODMソリューションその② ソフトのカスタマイズ

BIOS のカスタマイズ(ロゴ表示・デフォルト値の変更)や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。詳しくは弊社営業部までご相談下さい。弊社パートナーをご紹介させて頂きます。

ODMソリューションその③ パネルのステッカー製作

ステッカーの製作は200枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。

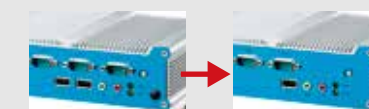


ODMソリューションその④ カラーチェンジ

ケースのカラーチェンジは200台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。

ODMソリューションその⑤ ボードのカスタマイズ

ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。



ODMソリューションその⑥ 各種認証取得

標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクコム・ジャパンオリジナル ネクコム IoT ソリューション

LTE通信内蔵対応、モバイルネットワークで 遠隔制御・稼働監視・遠隔保守・メンテナンスを実現

LTE モジュール

SIMCom Wireless Solution社製



SIM7600JC-H-MPCleモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80°C



SIM7600JC-H-M2モジュール

型式名	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンロード	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30~80°C

LTE 通信専用アンテナ



メーカー	キャセイ・トライテック	
品名	1 ダイポールアンテナ	2 無指向性アンテナ
型名	JSK-4G-401	CTA-002-2m
外形寸法 (mm)	-	-
ケーブル長 (m)	-	2
動作温度	-40~70°C	
取付方法	本体に直付け	両面テープ